

COIM destaca adesivo na Fispal Tecnologia

A COIM Brasil – Chimica Organica Industriale Milanese, empresa italiana especialista na fabricação de poliuretano e poliéster para diversas aplicações, localizada em Vinhedo, São Paulo, participa da edição 32ª edição da FISPAL Tecnologia. A feira é conhecida como a maior e mais completa do setor de Processos, Embalagens e Logística para as Indústrias de Alimentos e Bebidas da América Latina e acontece de 14 a 17 de junho no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo-SP.

Durante o evento, a empresa traz como destaque principal o Cold Seal HL 5812, um produto livre de látex natural que foi incluído na lista da RDC 26/2015 como sendo alergênico. Segundo o gerente de desenvolvimento da COIM, Carlos Gandolphi, o HL 5812 pode ser utilizado por selagem a frio para embalagens re-lacráveis (reclosable). “Este produto possui boa aderência e se fixa a diferentes tipos de papéis e filmes. Isso garante aos embalados, principalmente alimentos, proteção contra possíveis contaminações”, afirma.

O gerente ainda acrescenta que quando o assunto é segurança alimentar, a indústria de embalagens deve estar sempre atenta às adequações e às regulamentações vigentes e, portanto, a COIM está preparada para lançar inovações tecnológicas sempre que necessário no caso de novas resoluções.

A multinacional italiana também aproveitará o momento para reforçar a parceria com a marca americana NDC Technologies, responsável por desenvolver o leitor de gramatura – equipamento que verifica a medida real do adesivo aplicado online (g/m²) no ato da laminação, podendo ser corrigido durante o processo, de modo a evitar perdas e prejuízos. “Essa parceria e a demonstração dentro do estande irão auxiliar nossos clientes a obterem produtos de excelência, gerando a eles um grande potencial competitivo”, declara Gabriela Nobre, gerente de Marketing.

Além disso, a empresa também destaca dois adesivos. O NC 65/CA 38 G com base solvente que traz economia ao convertedor, pois, como é aplicado com 55% de sólidos, diminui a quantidade necessária de solvente, reduzindo o custo seco aplicado.

Já o adesivo solventless SF 5419/CA 5516 tem a vantagem de ser fácil de espalhar e não formar névoa durante a aplicação. Também possui alta resistência ao rasgo, rápida cura possibilitando o corte de 6 a 12h após a laminação. “Esse adesivo pode ser aplicado a baixas temperaturas e não apresenta sangramento de tinta, otimizando custos, prazo e qualidade”, explica Gandolphi.

Alternativa para driblar a crise — Sobre o cenário econômico desfavorável do Brasil, a Gerente de Marketing da COIM, Gabriela Nobre, afirma que a solução foi fortalecer a exportação. “Atualmente temos 45% do mercado da América do Sul. No Brasil, temos mais de 50 % de participação. Assim, a COIM mantém sua visão de ser uma empresa de classe mundial, líder e inovadora do mercado de adesivos de embalagens flexíveis”, diz.

Os produtos destacados durante a FISPAL Tecnologia estão disponíveis no portfólio da COIM para o mercado latino americano. Para atender estes mercados, a empresa possui representantes e distribuidores espalhados por diversos países como Colômbia, Chile, Peru, Equador, Argentina e Paraguai.

FISPAL Tecnologia, de 14 a 17 de junho, das 13h às 20h, no Pavilhão Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi Parque – Santana – São Paulo (SP). Estande: 073/074.

Perfil —A COIM (Chimica Organica Industriale Milanese) é uma empresa de origem italiana especializada em policondensação (éster), poliadição (poliuretanos) e grande fabricante de especialidades químicas. Fundada em 1962, em Milão, a empresa foi a primeira da Itália a produzir peróxidos orgânicos. Hoje, a multinacional opera em todos os países desenvolvendo soluções ondemande prestando serviços de qualidade para os mais importantes grupos do mundo. Possui unidades fabris na Itália, Brasil, Estados Unidos, Índia e Cingapura, além dos Centros de Pesquisa na Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Brasil.

